

2023年12月期 第1四半期 決算説明資料

株式会社レゾナック・ホールディングス

取締役 常務執行役員 CFO

染宮 秀樹

2023年5月15日

RESONAC

1

・当第1四半期(1-3月)は、HDメディアおよび半導体材料の需要低迷による半導体・電子材料セグメントの減収が、原燃料価格上昇を受けたケミカルセグメントの増収を上回り、前年同期比△91億円減収。

・営業利益は前年同期比で△250億円と大きく減益。需要冷え込みが続くHDメディア事業における在庫の処分や簿価切下げも減益要因。事業譲渡影響を除く継続事業ベースでは売上高△58億円減収、営業利益△248億円減益。

2

・半導体・電子材料業界の需要動向に不透明さは残るも、一定の前提の下2023年通期予想を算定。

・2023年は通期で△200億円の営業損失を見込み、前年比で△817億円と大きく減益となる想定。

目次

1. 2023年12月期 第1四半期決算
2. 2023年12月期 通期業績予想

連結業績の概要 (前年同期比)

(億円)

項目	2022年 1-3月※1	2023年 1-3月	増減
売上高	3,080	2,989	△ 91
営業利益	158	△ 92	△ 250
営業外損益	46	△ 17	△ 63
経常利益	203	△ 109	△ 312
特別損益	△ 23	△ 38	△ 15
税金等調整前四半期純利益	180	△ 147	△ 328
四半期純利益	126	△ 112	△ 238
親会社株主に帰属する 四半期純利益	89	△ 123	△ 211
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却費)	423	179	△ 244
対売上EBITDA%	13.7%	6.0%	△ 7.7p

参考 継続事業ベース※2 (億円)

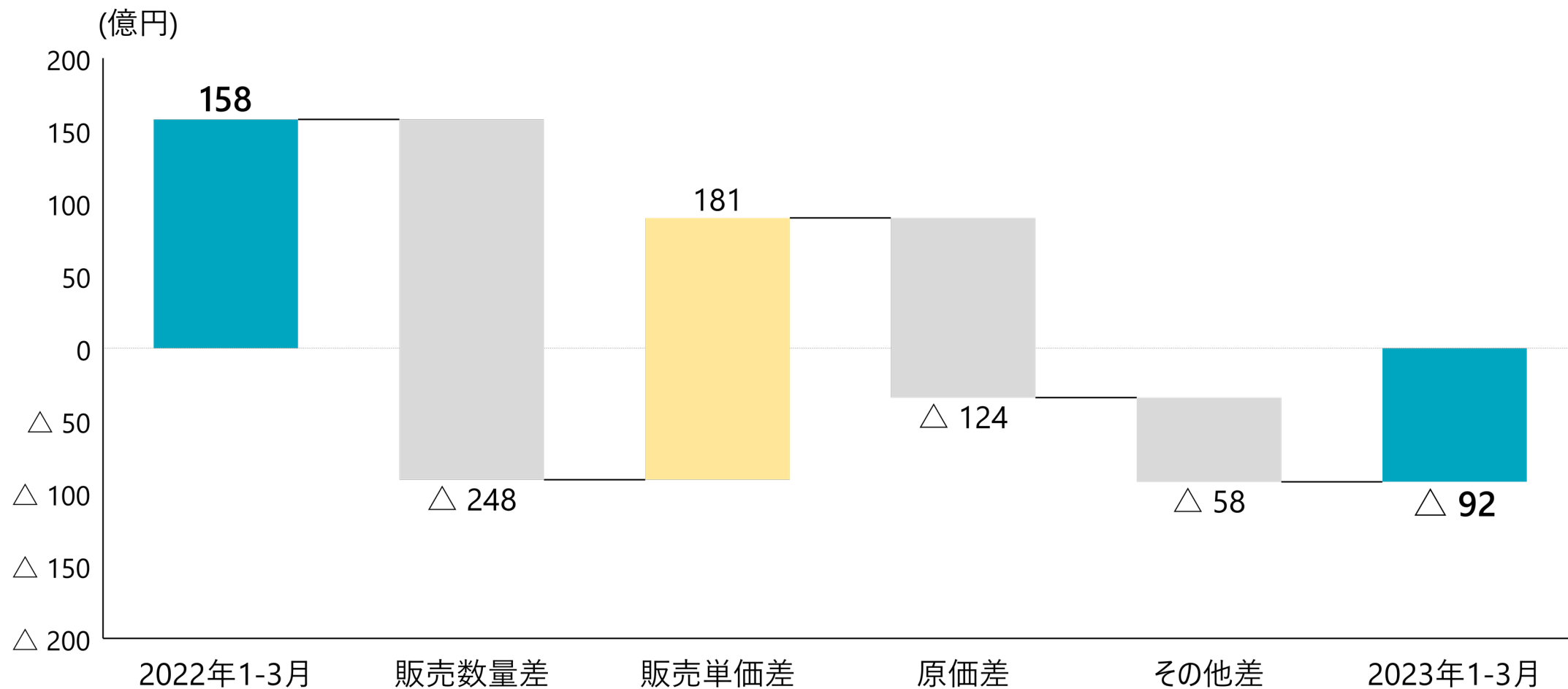
	2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減
売上高	3,048	2,989	△ 58
営業利益	156	△ 92	△ 248

EBITDA	421	179	△ 242
対売上 EBITDA%	13.8%	6.0%	△ 7.8p

※1 当期からの会計方針変更を遡及適用後の数値
他頁の2022年値についても同じ

※2 2022年に事業譲渡したISOLITE GmbHを除いた
参考値(監査対象外)

連結営業利益差異内訳 (前年同期比)



セグメント別売上高・営業利益・EBITDA (前年同期比)

(億円)

セグメント		2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減	増減率
半導体・電子材料	売上高	1,073	694	△ 380	△ 35%
	営業利益	132	△ 104	△ 235	-
	EBITDA	255	27	△ 228	△ 90%
モビリティ	売上高	444	425	△ 19	△ 4%
	営業利益	5	△ 5	△ 10	-
	EBITDA	51	42	△ 9	△ 17%
イノベーション材料	売上高	343	300	△ 43	△ 13%
	営業利益	29	20	△ 9	△ 30%
	EBITDA	50	42	△ 8	△ 16%
ケミカル	売上高	951	1,271	320	34%
	営業利益	22	39	17	73%
	EBITDA	64	82	18	29%
その他・調整額	売上高	269	299	30	11%
	営業利益	△ 30	△ 43	△ 12	-
	EBITDA	3	△ 14	△ 17	-
合計	売上高	3,080	2,989	△ 91	△ 3%
	営業利益	158	△ 92	△ 250	-
	EBITDA	423	179	△ 244	△ 58%

セグメント別売上高・営業利益 (半導体・電子材料) (前年同期比)

(億円)

項目	2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減	増減率	業績概況
売上高	1,073	694	△ 380	△ 35%	前年後半からの需要低迷が継続し、大幅減収。 HDメディアの棚卸資産において、低価法による簿価切り下げや廃棄損を計上したこともあり、営業赤字 ・半導体前工程材料: 当期から半導体前工程の生産調整の影響が生じ、電子材料用高純度ガス、CMPスラリーとともに減収 ・半導体後工程材料: 半導体後工程の生産調整の影響が継続し、主要製品全て減収 ・デバイスソリューション: HDメディアはデータセンター向け需要低迷が継続し、大幅減収。SiCエピタキシャルウェハは出荷数量増で増収
半導体前工程材料	234	205	△ 29	△ 12%	
半導体後工程材料	469	325	△ 144	△ 31%	
デバイスソリューション	297	106	△ 192	△ 64%	
その他	73	58	△ 14	△ 20%	
営業利益	132	△ 104	△ 235	-	

主要製品

- 半導体前工程材料: 電子材料用高純度ガス、半導体回路平坦化用研磨材料(CMPスラリー)
- 半導体後工程材料: エポキシ封止材、ダイボンディング材料、銅張積層板、感光性フィルム、感光性ソルダーレジスト
- デバイスソリューション: HDメディア、SiCエピタキシャルウェハ、化合物半導体(LED)

セグメント別売上高・営業利益 (モビリティ) (前年同期比)

(億円)

項目	2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減	増減率	業績概況
売上高	444	425	△ 19	△ 4%	前年7-9月期に実施したISOLITE GmbH事業譲渡の影響を受けたほか、一部製品で民生需要の低迷の影響を受けたことで、減収減益 ・自動車部品: 事業譲渡の影響を除くと、新規車種向け製品の立上や北米地域における自動車生産の回復により、樹脂成形品、摩擦材、粉末冶金製品それぞれ増収 ・リチウムイオン電池材料: 正負極用導電助剤、カーボン負極材は増収となったものの、民生需要の低迷により、アルミラミネートフィルム(SPALF)が減収
自動車部品	356	352	△ 4	△ 1%	
リチウムイオン電池材料	89	71	△ 18	△ 20%	
その他	△ 1	2	3	-	
営業利益	5	△ 5	△ 10	-	

主要製品

- 自動車部品: 樹脂成形品、摩擦材、粉末冶金製品
- リチウムイオン電池材料: アルミラミネートフィルム(SPALF)、正負極用導電助剤、カーボン負極材

セグメント別売上高・営業利益 (イノベーション材料・ケミカル) (前年同期比)

(億円)

項目		2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減	増減率	業績概況
イノベーション 材料	売上高	343	300	△ 43	△ 13%	原材料価格高騰に伴う値上げにより製品販売価格は上昇したが、販売数量減により減収。数量減や原材料価格高騰のコスト増加分の価格転嫁タイムラグ等により減益
	営業利益	29	20	△ 9	△ 30%	
ケミカル	売上高	951	1,271	320	34%	<ul style="list-style-type: none"> ・石油化学: ナフサ価格上昇による販売単価上昇に加え、前年は4年に一度の定修・地震による停止があったため販売数量も増加し増収増益 ・化学品: 原燃料上昇に対応した価格転嫁が進み増収増益 ・黒鉛電極: 前年比で出荷数量は減ったものの、原価上昇にキャッチアップした値上げにより増収、受払差のマイナス影響により減益
	石油化学	522	780	258	49%	
	化学品	177	207	31	17%	
	黒鉛電極	251	283	32	13%	
	その他	0	△ 0	△ 1	-	
	営業利益	22	39	17	73%	

主要製品

- イノベーション材料: 樹脂材料、機能性化学品、コーティング材料、セラミックス、アルミ機能部材
- 石油化学: オレフィン、有機化学品
- 化学品: 産業ガス、基礎化学品

営業外損益内訳

(億円)

項目	2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減
金融収支	△ 13	△ 29	△ 16
持分法投資損益	11	9	△ 3
その他	47	3	△ 44
営業外損益 計	46	△ 17	△ 63

特別損益内訳

(億円)

項目	2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減
投資有価証券売却益	1	4	3
固定資産除売却損	△ 7	△ 12	△ 5
減損損失	△ 1	△ 29	△ 28
その他	△ 16	△ 1	15
特別損益 計	△ 23	△ 38	△ 15

連結貸借対照表

(億円)

資産	2022年 12月末※1	2023年 3月末	増減	負債・純資産	2022年 12月末※1	2023年 3月末	増減
現預金	1,873	1,709	△ 164	営業債務	1,941	1,746	△ 195
営業債権	2,653	2,318	△ 335	有利子負債	10,626	10,537	△ 89
たな卸資産	2,505	2,528	23	その他負債	2,623	2,421	△ 202
その他流動資産	840	695	△ 145	負債計	15,190	14,704	△ 487
流動資産計	7,870	7,249	△ 621	株主資本計	4,446	4,208	△ 237
有形固定資産計	6,781	6,797	16	(内、利益剰余金)	1,659	1,422	△ 237
無形固定資産計	4,937	4,875	△ 62	その他の包括利益累計額計	1,057	1,097	40
(内、のれん)	2,954	2,912	△ 42	(内、その他有証評価差額金)	4	1	△ 2
(内、その他無形固定資産)	1,983	1,963	△ 20	(内、為替換算調整勘定)	720	778	58
投資その他の資産計	1,350	1,342	△ 7	非支配株主持分	244	255	10
固定資産計	13,067	13,014	△ 53	純資産計	5,747	5,560	△ 188
資産合計	20,937	20,263	△ 674	負債・純資産合計	20,937	20,263	△ 674

主要指標

ネットD/Eレシオ (倍)※2	1.07	1.12	0.04p	自己資本比率 (%)※3	26.3	26.2	△ 0.1p
-----------------	------	------	-------	--------------	------	------	--------

※1 当期からの会計方針変更を遡及適用後の数値。他頁の2022年値についても同じ

※2 {(借入金+コマーシャルペーパー+社債+リース債務) - 現金及び預金 - 劣後ローン×50%} ÷ (自己資本+劣後ローン×50%)

劣後ローン(借入金に含まれる)の50%の資本性は、2020年4月27日付の(株)日本格付研究所の格付に基づく

※3 {(純資産計 - 非支配株主持分)/負債・純資産合計} x 100

目次

1. 2023年12月期 第1四半期決算
2. 2023年12月期 通期業績予想

2023年連結業績予想

(億円)

項目	2022年 実績※1	2023年 通期予想※2	増減	2023年	
				上期予想	下期予想
売上高	13,926	13,400	△ 526	6,400	7,000
営業利益	617	△ 200	△ 817	△ 200	0
営業外損益	△ 0	△ 110	△ 110	△ 40	△ 70
経常利益	617	△ 310	△ 927	△ 240	△ 70
特別損益	△ 108	△ 170	△ 62	△ 100	△ 70
税金等調整前当期純利益	509	△ 480	△ 989	△ 340	△ 140
当期純利益	397	△ 430	△ 827	△ 300	△ 130
親会社株主に帰属する 当期純利益	324	△ 460	△ 784	△ 320	△ 140
1株当たり当期純利益	179円02銭	△253円98銭	△433円00銭		
1株当たり配当金	65円	未定	-		

※1 当期からの会計方針変更を遡及適用後の数値。他頁の2022年値についても同じ

※2 2023年5月15日公表

(億円)

セグメント	項目	2023年 今回予想 ^{※1}					2023年 前回予想 ^{※2}		2022年
		1Q実績	2Q予想	上期予想	下期予想	通期予想	1Q予想	増減	通期実績
半導体・電子材料	売上高	694	806	1,500	2,000	3,500	800	△ 106	4,272
	営業利益	△ 104	△ 96	△ 200	△ 20	△ 220	△ 105	1	455
モビリティ	売上高	425	475	900	900	1,800	430	△ 5	1,806
	営業利益	△ 5	△ 10	△ 15	△ 10	△ 25	△ 15	10	△ 7
イノベーション材料	売上高	300	400	700	700	1,400	330	△ 30	1,411
	営業利益	20	20	40	40	80	15	5	101
ケミカル	売上高	1,271	1,429	2,700	2,800	5,500	1,340	△ 69	5,278
	営業利益	39	41	80	110	190	20	19	249
その他・調整額	売上高	299	301	600	600	1,200	300	△ 1	1,159
	営業利益	△ 43	△ 62	△ 105	△ 120	△ 225	△ 55	12	△ 181
合計	売上高	2,989	3,411	6,400	7,000	13,400	3,200	△ 211	13,926
	営業利益	△ 92	△ 108	△ 200	0	△ 200	△ 140	48	617

※1 2023年5月15日公表

※2 2023年2月14日公表

構造改革の推進

事業環境の変化を捉えた、抜本的・非連続的なアクションの実施

シクリカリティを前提とした
生産規模の最適化

注力市場・製品の見直し
を含む戦略転換

新戦略に基づく
リソースの再配置

HDメディア

- ・HDメディア生産規模および人員規模の最適化
(生産能力2割削減)
- ・1Q末までに大半の滞留懸念在庫を処分

モビリティ

- ・構造改革推進室を設置
- ・セグメント売上高の3割を占める赤字製品x顧客の組み合わせについて、抜本的な値上げ、もしくは撤退の顧客対話を本格加速
- ・関西拠点統廃合の決定

赤字製品の撲滅

- ・左の2事業以外についても、国内取引を中心に赤字製品x顧客の組み合わせをリストアップ、収益改善策の立案・実行を加速

2023年3月末時点の進捗状況※
収益改善施策完了: 51%(値上げ・撤退等)
取組中: 28%
(うち80%が2023年12月末完了予定)

※本集計上、市況影響の大きい石油化学事業は除く

Appendix

連結対象会社 (前期末対比)

連結子会社： 104社 (△4社)

△ 3社: 海外拠点統合関連

△ 1社: 旧日立化成(株)買収SPC 吸収合併による消滅 (HCホールディングス株式会社)

持分法適用会社： 12社 (△1社)

主要諸元

(期中平均)

	2022年	2023年	2022年	2023年
	1-3月	1-3月	通期実績	通期予想
為替レート				
(円/US\$)	116.2	132.3	131.4	132.0
	2022年3月 期末レート:122.4	2023年3月 期末レート:133.5	2022年12月 期末レート:132.7	
(円/€)	130.4	142.1	138.0	142.0
国産ナフサ (円/KL)	64,600	66,500	76,150	65,700

(億円)

	2022年 1-3月実績※	2023年 1-3月実績	増減
設備投資	231	210	△ 21
減価償却費	223	229	6
研究開発費	112	103	△ 9
金融収支	△ 13	△ 29	△ 16
優先株配当	△ 32	-	32

※ 当期からの会計方針変更を遡及適用後の数値。他頁の2022年値についても同じ

(億円)

セグメント	2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減
半導体・電子材料	129	109	△ 20
モビリティ	18	24	5
イノベーション材料	17	13	△ 5
ケミカル	41	38	△ 2
その他	26	26	1
合計	231	210	△ 21

(億円)

セグメント		2022年 1-3月	2023年 1-3月	増減
半導体・電子材料	減価償却費	90	97	7
	のれん償却額	33	33	0
モビリティ	減価償却費	41	42	1
	のれん償却額	5	5	0
イノベーション材料	減価償却費	19	20	0
	のれん償却額	2	2	0
ケミカル	減価償却費	41	43	2
	のれん償却額	0	0	0
その他	減価償却費	32	27	△ 5
	のれん償却額	2	2	0
継続事業ベース※ 合計	減価償却費	223	229	6
	のれん償却額	42	42	0
非継続事業	減価償却費	-	-	0
	のれん償却額	-	-	0
合計	減価償却費	223	229	6
	のれん償却額	42	42	0

※ 2022年に事業譲渡したISOLITE GmbHを除いた参考値(監査対象外)

(億円)

項目	2022年 10-12月※	2023年 1-3月	増減
売上高	3,585	2,989	△ 595
営業利益	70	△ 92	△ 162
営業外損益	△ 106	△ 17	89
経常利益	△ 36	△ 109	△ 73
特別損益	62	△ 38	△ 100
税金等調整前四半期純利益	26	△ 147	△ 173
四半期純利益	△ 40	△ 112	△ 72
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 43	△ 123	△ 80
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却費)	348	179	△ 169
対売上EBITDA%	9.7%	6.0%	△ 3.7p

※ 当期からの会計方針変更を遡及適用後の数値。他頁の2022年値についても同じ

(億円)

セグメント		2022年※1				
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	通期実績
半導体・電子材料	売上高	1,073	1,130	1,120	948	4,272
	営業利益	132	141	132	50	455
モビリティ	売上高	412	389	450	457	1,708
	営業利益	3	△ 12	1	7	△ 1
イノベーション材料	売上高	343	357	356	355	1,411
	営業利益	29	26	21	25	101
ケミカル	売上高	951	1,295	1,525	1,508	5,278
	営業利益	22	109	62	56	249
その他	売上高	269	276	299	315	1,159
	営業利益	△ 30	△ 40	△ 42	△ 68	△ 181
継続事業ベース※2 合計	売上高	3,048	3,446	3,749	3,585	13,828
	営業利益	156	224	174	70	624
非継続事業	売上高	32	34	32	0	98
	営業利益	2	△ 2	△ 6	0	△ 7
合計	売上高	3,080	3,480	3,781	3,585	13,926
	営業利益	158	222	168	70	617

※1 当期からの会計方針変更を遡及適用後の数値。他頁の2022年値についても同じ

※2 2022年に事業譲渡したISOLITE GmbHを除いた参考値(監査対象外)

セグメント	トピックス
全社	「第2回日経統合報告書アワード」でグランプリを受賞 ～「トップマネジメントのメッセージ」項目で満点評価～
	社外取締役就任のお知らせ ～半導体装置メーカーで会長経験を持つ常石氏の参画により、半導体分野の経営力を強化～
半導体・ 電子材料	パワー半導体向けSiC材料についてInfineon Technologiesとの提携関係を強化
	ハイグレードSiCエピウェハー第3世代品を開発、量産を開始 ～世界最高水準の品質のエピウェハー供給により、高出力と省スペースを両立する次世代パワー半導体の実用化に貢献～
	パワー半導体用SiCエピウェハーがデンソー製インバーターに採用 ～トヨタ自動車の新型電動車LEXUS「RZ」に搭載～
その他	連結子会社における株式譲渡（孫会社及び曾孫会社の異動）による日本、アメリカ及び中国診断薬事業の譲渡に関するお知らせ

ニュースリリース

詳細は各ニュースリリースをご参照ください。

<https://www.resonac.com/jp/news>

注意事項

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。

なお、法令に定めのある場合を除き、当社はこれらの将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、ナフサ等原材料価格、黒鉛電極等製品の需要動向および市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。